

# Styler D'aspiration Sous Vide Pour Plaquettes En Peek Antistatique Haute Précision Pour La Manipulation De Substrats Semi-Conducteurs Et Photovoltaïques De 8 Pouces

Numéro d'article: PL-CP115



## Introduction

Styler d'aspiration sous vide pour plaquettes en PEEK antistatique haute performance conçu pour la manipulation précise de plaquettes de 8 pouces dans les secteurs semi-conducteurs et photovoltaïques. Cette solution personnalisable offre une résistance chimique supérieure et une durabilité mécanique exceptionnelle pour les environnements de salle blanche critiques et les processus de transfert de substrats délicats.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Inspection de plaquettes	Transfert manuel de plaquettes de silicium de 8 pouces vers et depuis des postes d'inspection optique ou MEB.	La zone de contact minimale réduit le risque de génération de défauts de surface.
Tri de cellules photovoltaïques	Manipulation et tri de cellules solaires à haut rendement pendant les phases d'assemblage et de test.	Empêche les micro-fissures et préserve le rendement des cellules grâce à une prise sous vide douce.
Traitement sur banc humide	Transfert de substrats entre bains chimiques ou postes de rinçage dans des environnements de chimie humide.	Résistance exceptionnelle aux produits chimiques de traitement agressifs et à l'humidité.
Dépôt de couches minces	Placement et retrait de substrats des chambres à vide PVD/CVD ou des sas de chargement.	Une stabilité thermique élevée permet la manipulation après des cycles de dépôt à haute température.
R&D en salle blanche	Manipulation générale de substrats dans les installations de recherche et développement de matériaux avancés.	Préserve les normes de propreté ISO strictes en minimisant l'émission de particules.
Préparation pour collage de puce	Positionnement manuel de plaquettes pour le découpage ou les opérations de collage de puce ultérieures.	Les propriétés antistatiques préviennent les défauts latents sur les microcircuits sensibles.
Manipulation de substrats pour LED	Manipulation précise de substrats en saphir ou SiC pendant la fabrication de puces LED.	Prise sécurisée sur des surfaces dures et polies sans glissement ni rayure.

Catégorie de spécification	Détail de la spécification PL-CP115
Identification du modèle	Série PL-CP115
Matériau principal	PEEK antistatique haute performance
Compatibilité avec les substrats	Entièrement personnalisable (optimisé pour des plaquettes de 8 pouces/200 mm)
Résistance de surface	Personnalisable selon des gammes antistatiques spécifiées (par exemple, $10^6 - 10^9 \Omega$ )
Plage de température de fonctionnement	Personnalisée en fonction des exigences du processus
Compatibilité chimique	Universelle (très résistante à la plupart des acides, des bases et des solvants)

Application	Description	Avantage clé
Catégorie de spécification	Détail de la spécification PL-CP115	
Type de connexion pour le vide	Dimensionnement sur mesure pour correspondre aux lignes de vide de l'installation ou aux pompes portatives	
Configuration de la pointe	Formes personnalisées (plates, courbes, multipoints) disponibles sur demande	
Classification salle blanche	Compatible avec les classes ISO 3 - 8 (dépendant de l'application)	
Méthode de fabrication	Usinage CNC de précision selon des spécifications sur mesure	
Dimensions de la poignée	Conception ergonomique adaptée aux préférences du client	